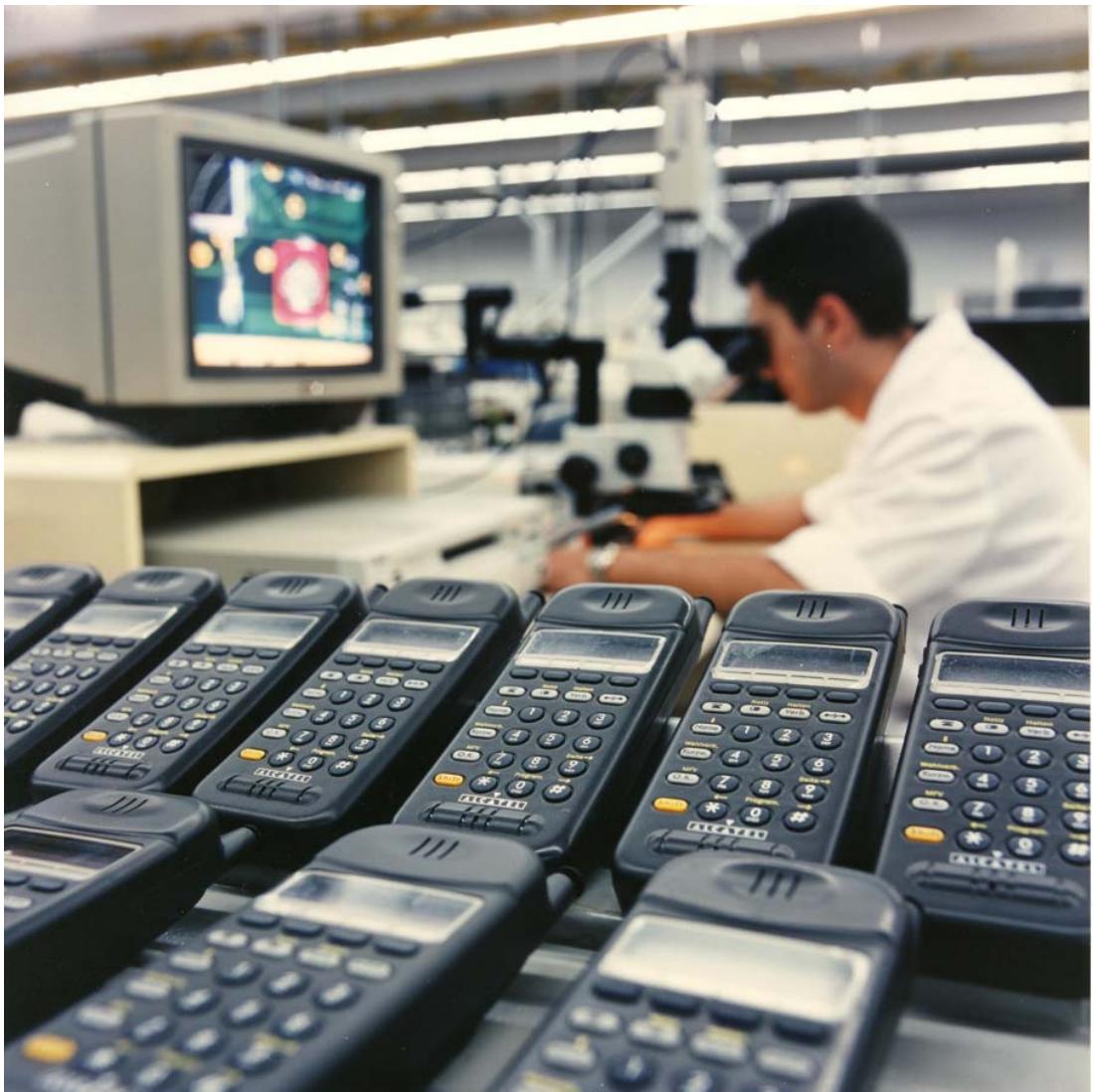


**Fábrica de Alcatel Citesa en el Parque Tecnológico de Andalucía.  
Avda. Juan López de Peñalver. Campanillas. Málaga**



Panorámica de la nueva planta  
industrial de Alcatel Citesa



Cadena de producción de terminales DECT (Digital European Cordless Telephone) de Alcatel Citesta



Puesto de reparación y prueba  
de estaciones base del sistema  
DECT en las instalaciones de  
Alcatel Citesa



Cadena de producción de teléfonos de previo pago de Alcatel Citesta



Puesto de control de calidad de terminales inalámbricos en la nueva factoría de Alcatel Citesa



Cadena de producción del teléfono Forma en las nuevas instalaciones de Alcatel Citesa



Vista del almacén automatizado  
de la nueva factoría de Alcatel  
Citesa



08. Vista del Taller de PBA's (Printed Board Assembly) (Ensamble de Circuitos Impresos).



09. Vista del Taller de PBA's (Printed Board Assembly) (Ensamble de Circuitos Impresos).



10. Vista del Taller de PBA's (Printed Board Assembly) (Ensamble de Circuitos Impresos).



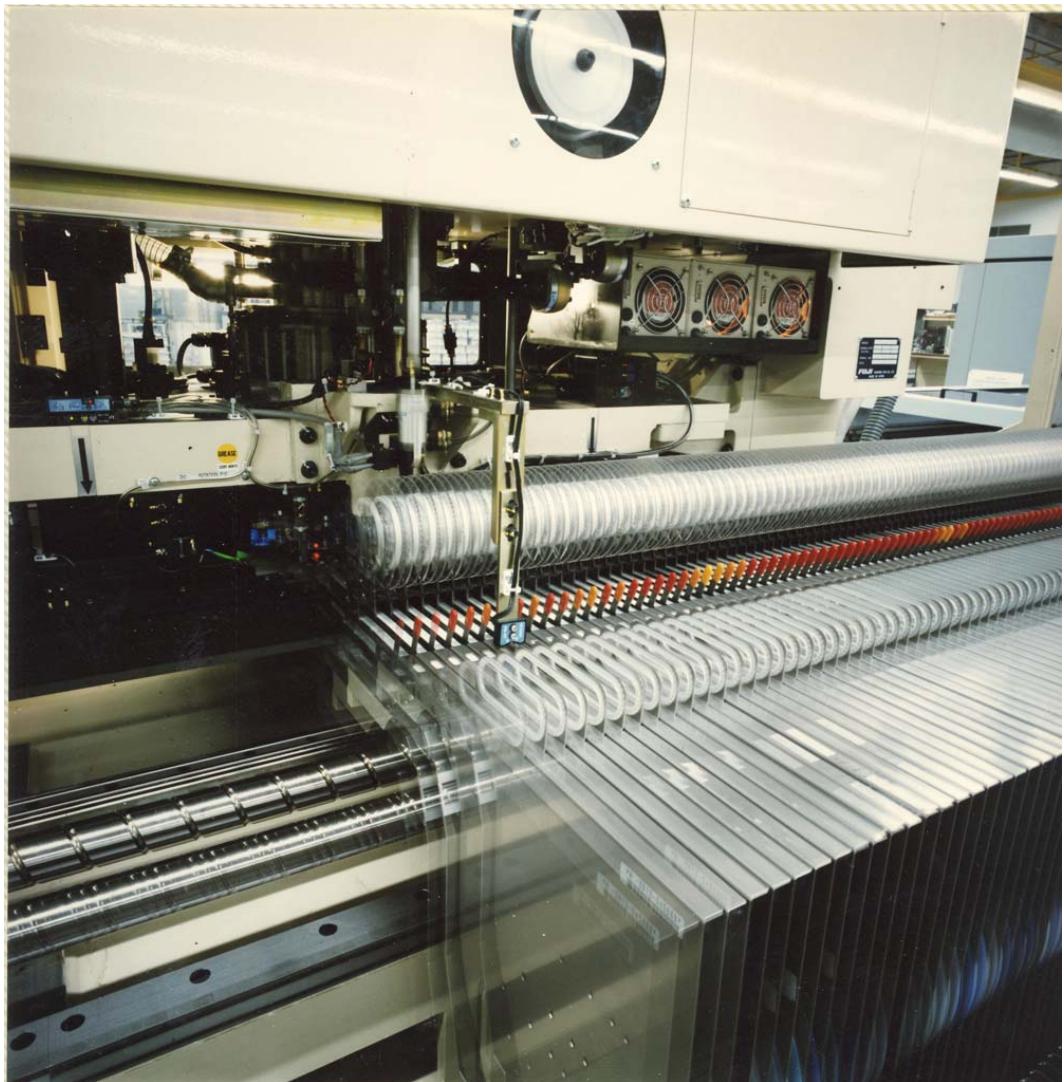
11. Vista del Taller de PBA's (Printed Board Assembly) (Ensamble de Circuitos Impresos).



12. Puesto de ensamble de DECT en línea



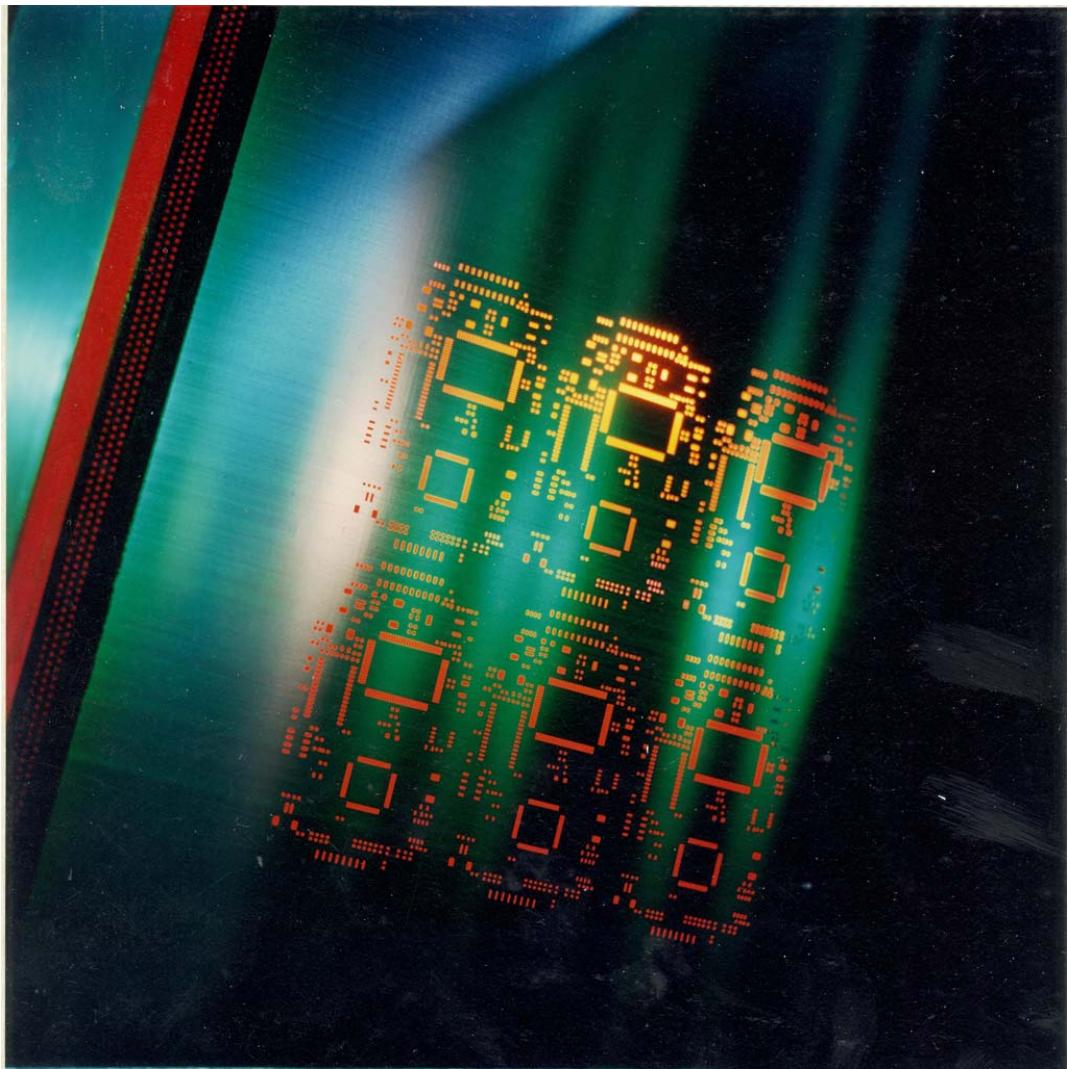
13. Entrada de placas a horno de atmósfera inerte para Soldadura por refusión de SMD's (Surface Mounted Devices)



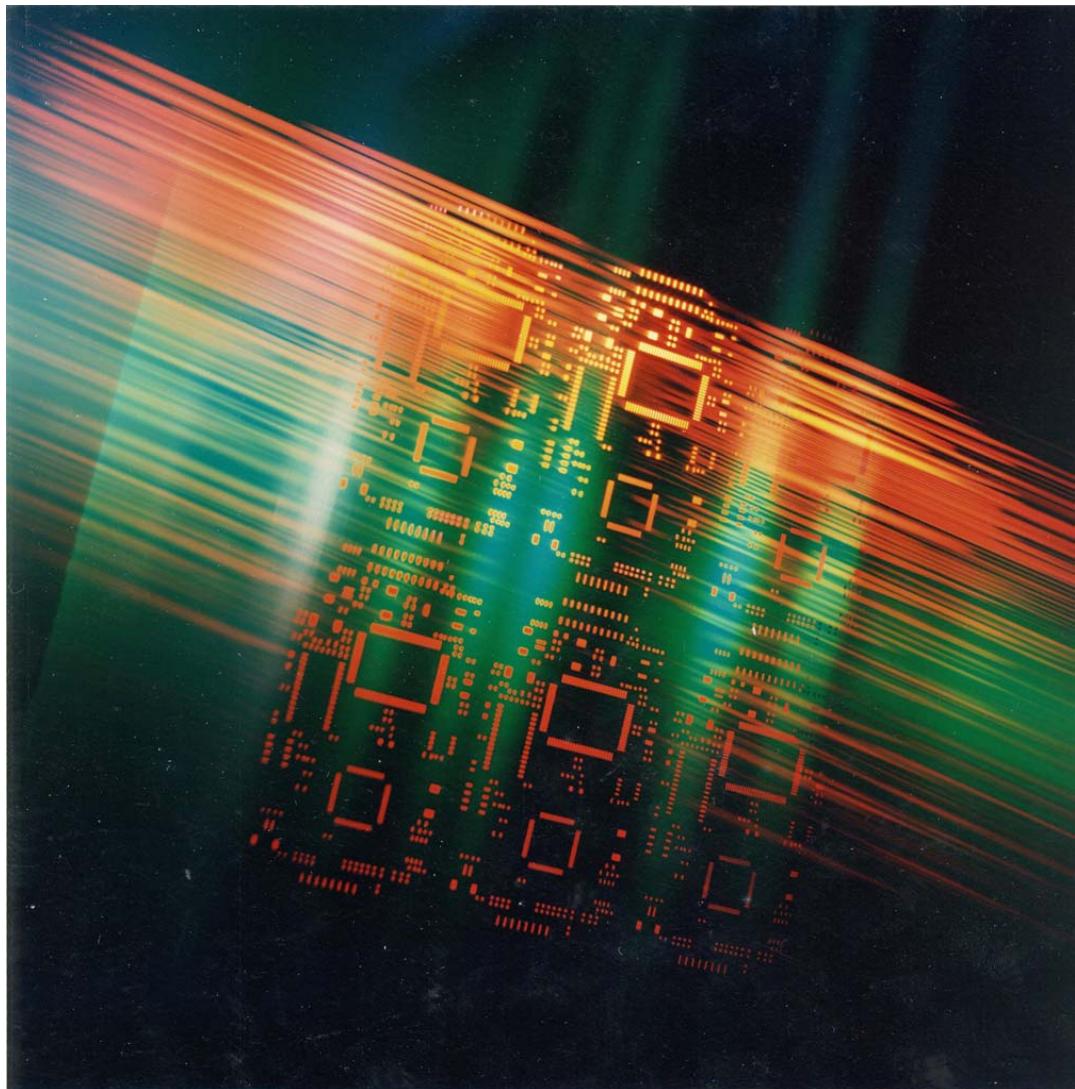
14. Parte posterior de máquina Fuji CP de ensamble en automático de SMD's (Surface Mounted Devices)



15. Detalle de cabezal de máquina Fuji IP de ensamble de SMD's (Surface Mounted Devices)



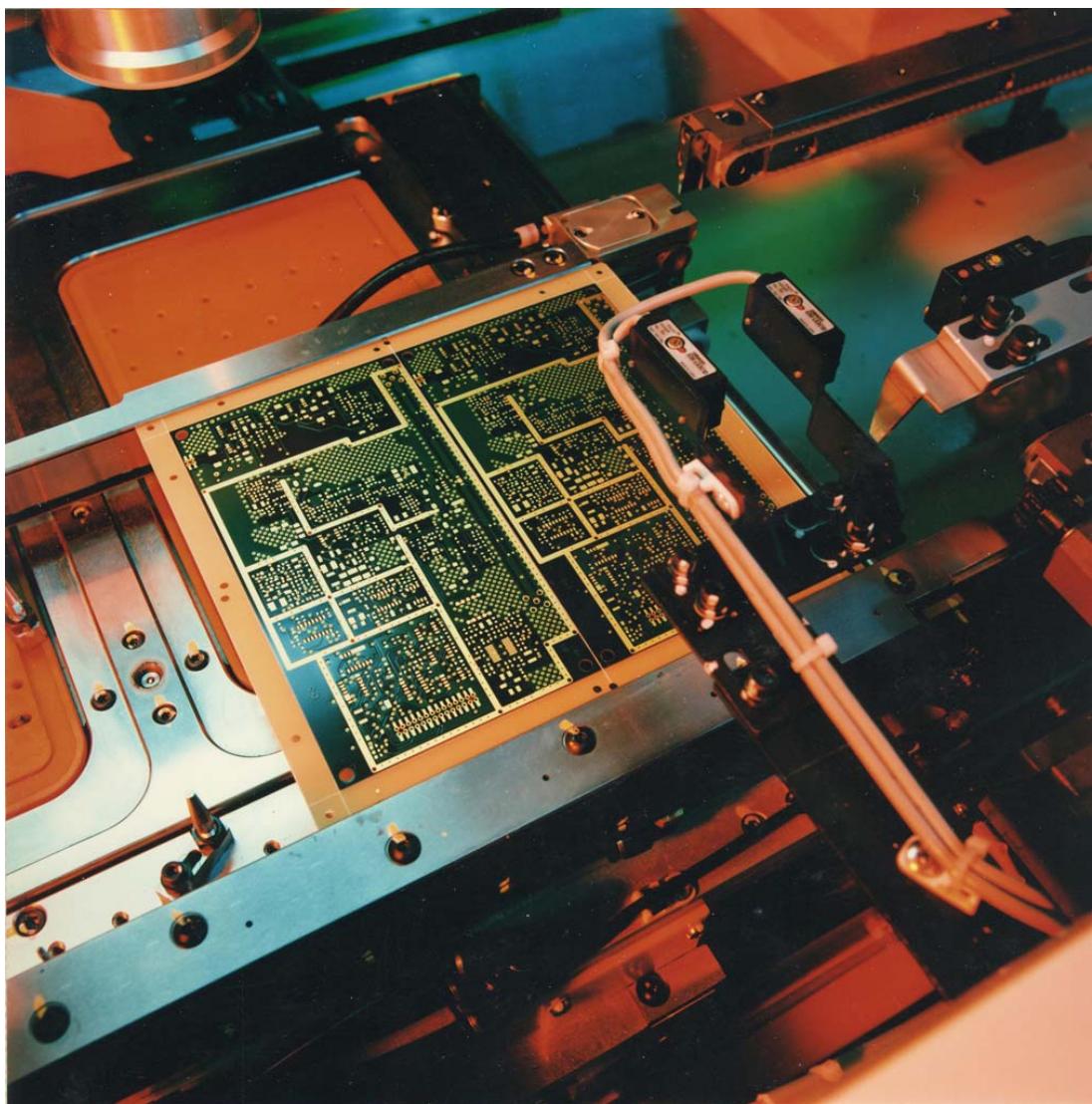
16. Multipanel de 3 circuitos impresos de teléfono DECT



17. Visión artística de Multipanel de 3 circuitos impresos de teléfono DECT



18. Multipanel de 6 circuitos impresos de teléfono DECT.

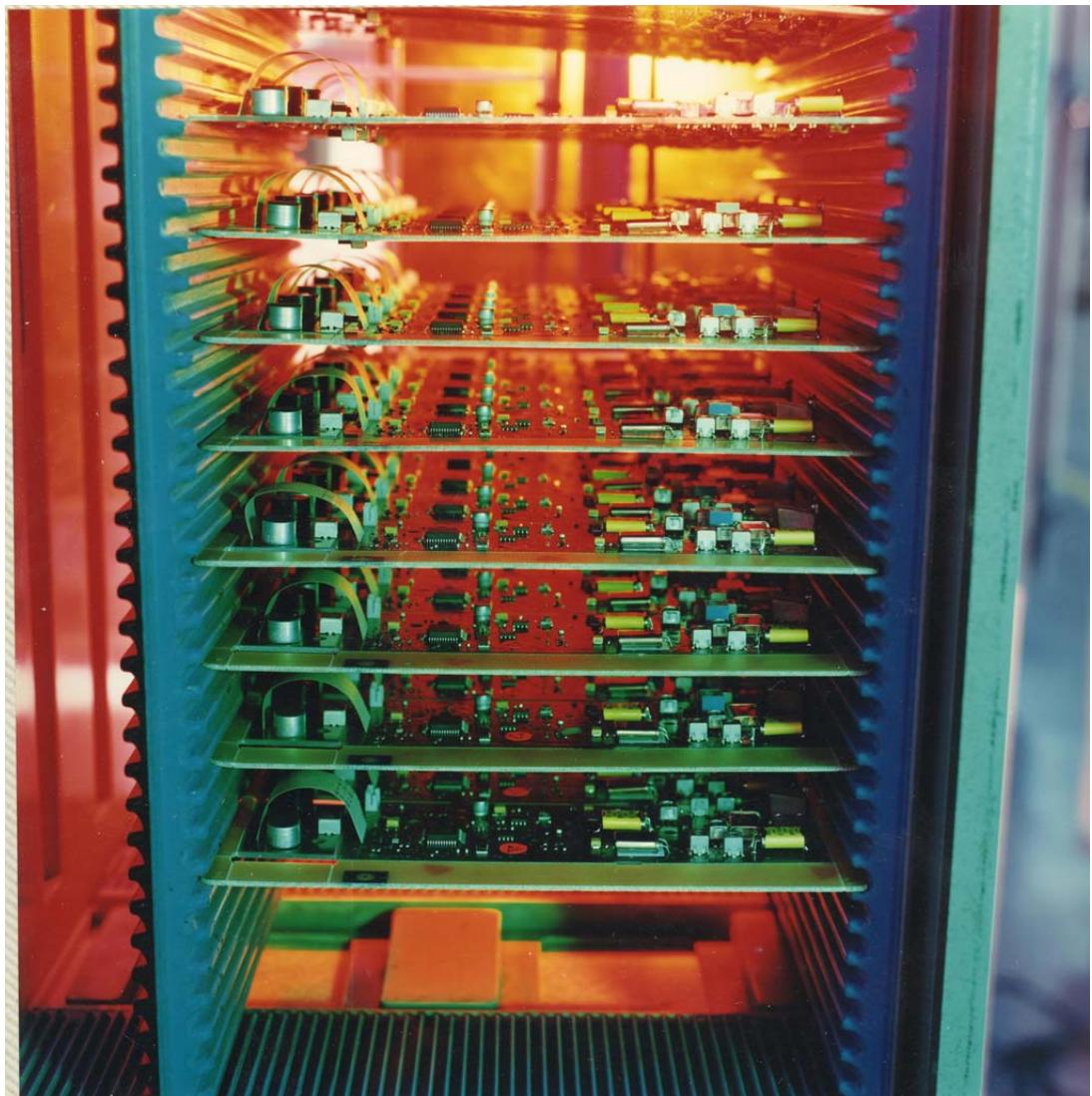


19. Multipanel de 2 circuitos impresos de estación base DECT, preparado para el ensamble SMD's (Surface Mounted Devices) en máquina Fuji.



20. Vista del Taller de PBA's (Printed Board Assembly) (Ensamble de Circuitos Impresos).

En primer término, horno de soldadura en atmósfera inerte.



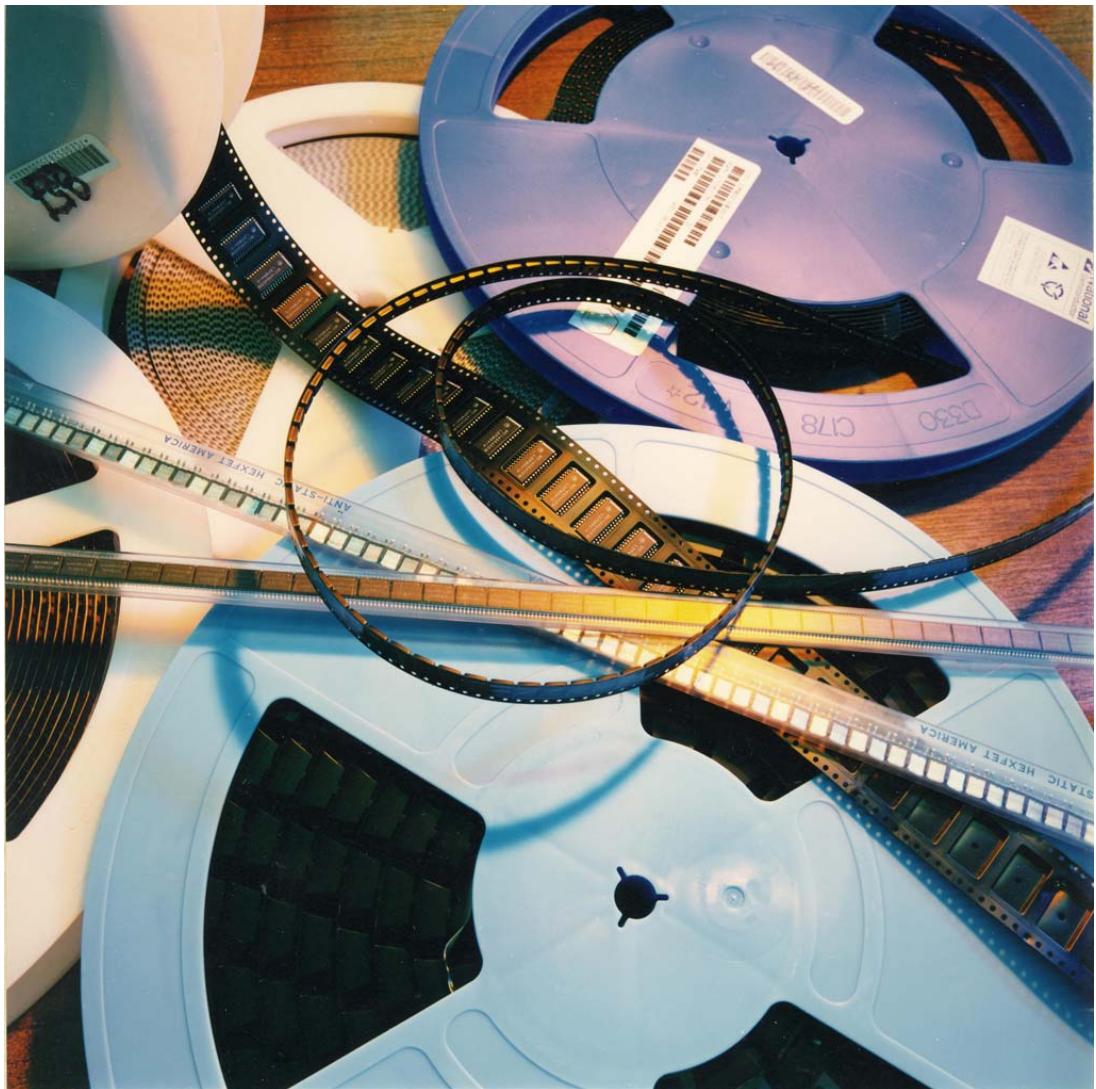
21. Contenedor para almacenaje de circuitos impresos ensamblados



22. Puesto de prueba manual de placas ensambladas.



23. Puesto de prueba manual de teléfono inalámbrico



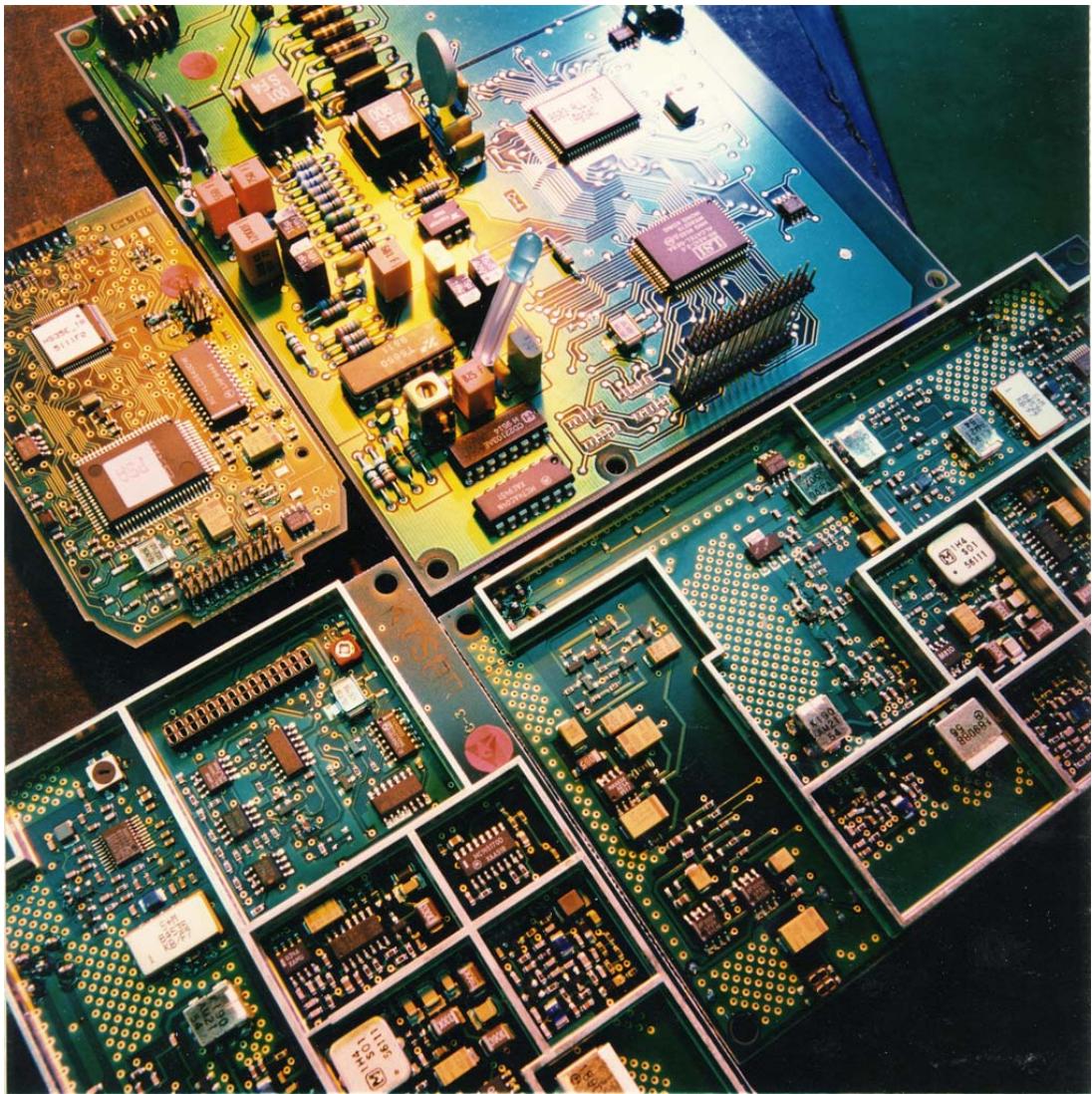
24. Carretes de almacenamiento y transporte de circuitos integrados



25. Vista del Taller de PBA's (Printed Board Assembly) (Ensamble de Circuitos Impresos).



26. Línea de ajuste y prueba manual de placas de teléfonos inalámbricos



27. Placas ensambladas de equipos DECT



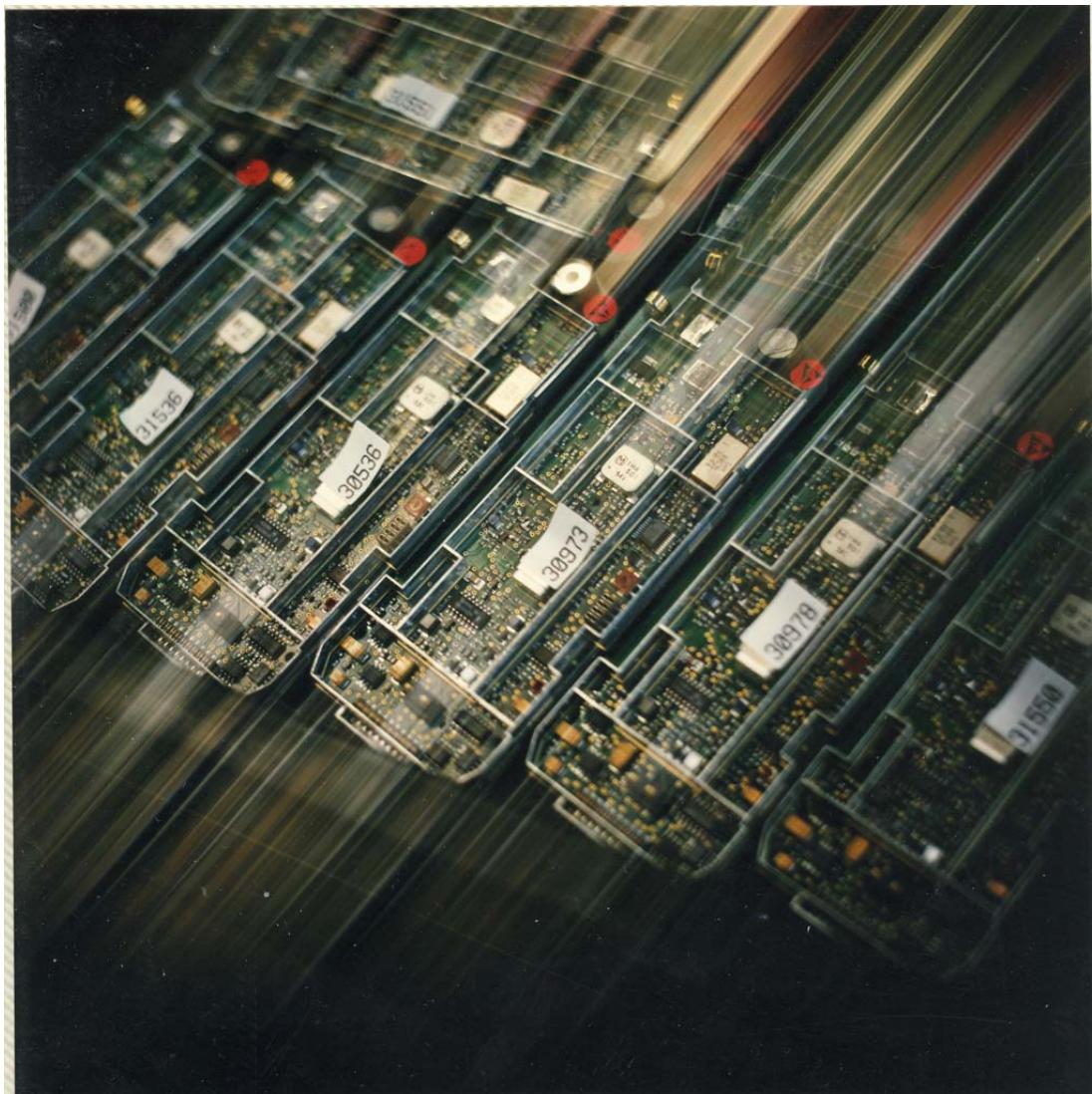
28. Microscopio para inspección de circuitos impresos con cámara para monitor



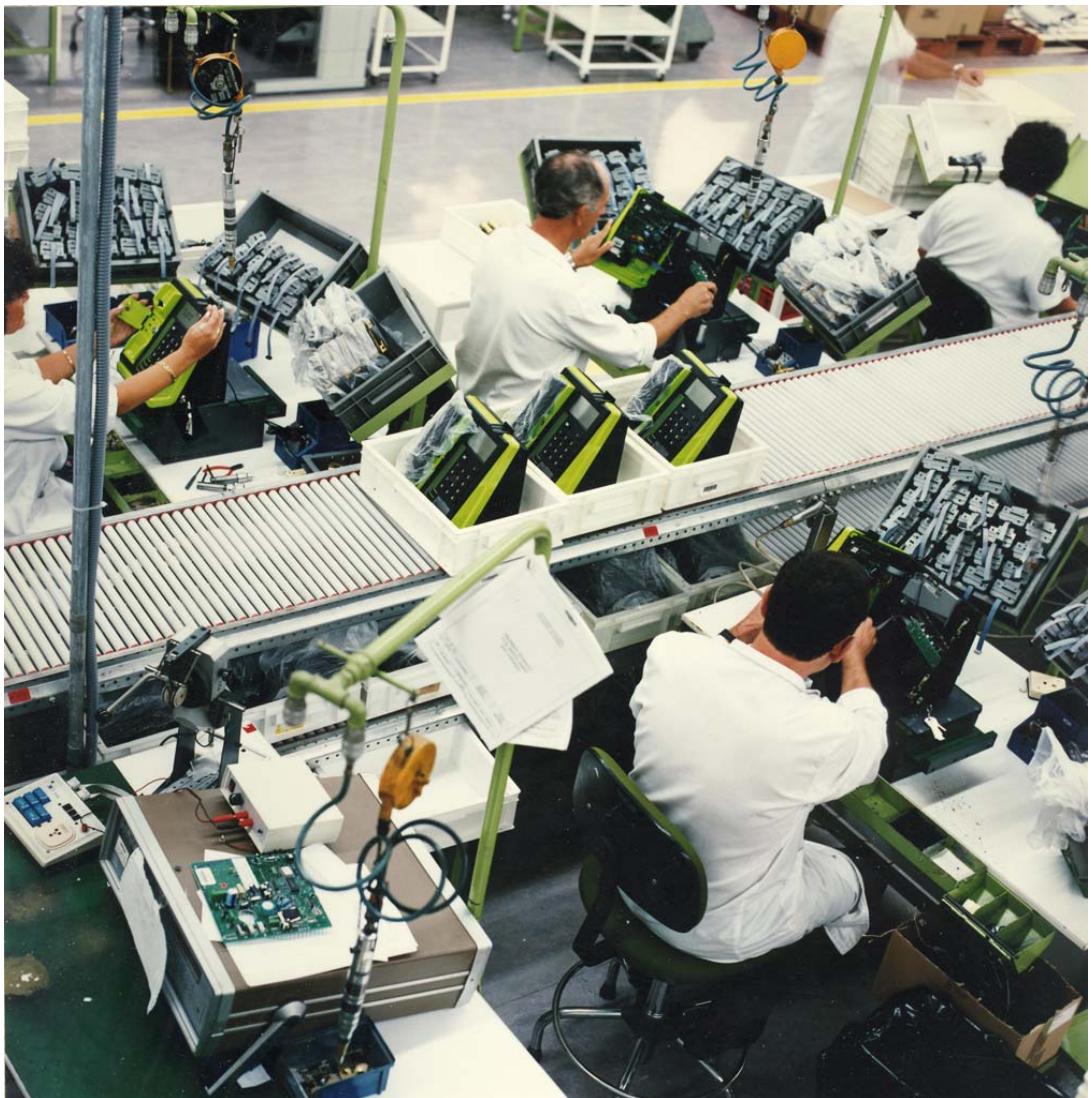
29. Equipo de prueba de estación base DECT de intemperie



30. Ajuste y prueba manual de circuitos impresos ensamblados del teléfono DECT.



31. Visión artística de circuitos impresos ensamblados del teléfono DECT



32. Línea del teléfono de monedas PIA. (Previopago Interiores Autónomo)



33. Puestos de prueba en automático del teléfono Forma



34. Empaque de teléfonos Forma



35. Diseño asistido por ordenador de Circuitos impresos (CAD. Computer Aided Design)



36. Diseño asistido por ordenador de aparatos telefónicos (CAD. Computer Aided Design)



37. Diseño asistido por ordenador de aparatos telefónicos (CAD. Computer Aided Design)



38. Diseño asistido por ordenador de aparatos telefónicos (CAD. Computer Aided Design)